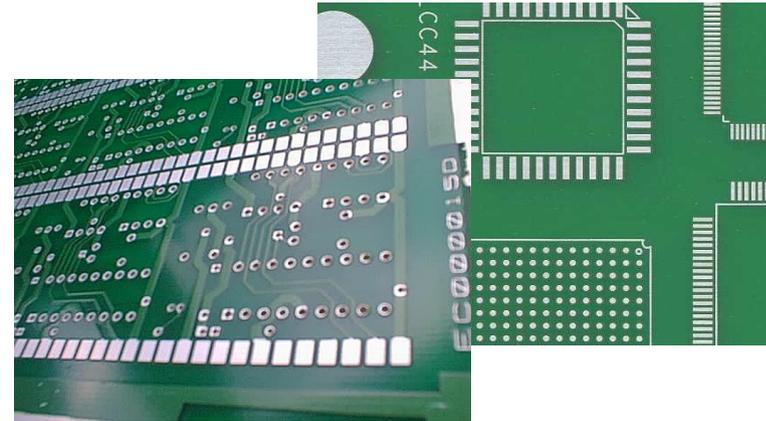


## Características

- Cumple RoSH (sin plomo).
- Especial Pres-fits y BGAs.
- Múltiples reflows.
- Durabilidad 12 meses.
- Es reprocesable.

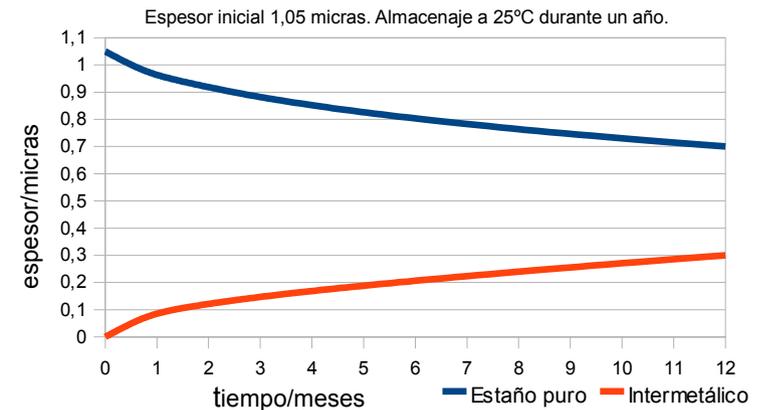


*Se aplica estaño puro con un espesor de poco más de 1 $\mu$ . Ofrece una gran soldabilidad y debido a la micra de espesor, tiene una alta capacidad lubricante, que lo hace especialmente aconsejable para pin connectors, back planes y press fits. Por su excelente planicidad, también está indicado para todo tipo de SMDs y BGAs.*

## Pautas de almacenaje

- Gestión de stock FIFO.
- Temperatura controlada, entre 20°C y 25°C aproximadamente.
- Almacenaje máximo de 12 meses.
- Reducir la manipulación.

### Como afecta el tiempo y la temperatura?



El tiempo y la temperatura reducen la vida útil del Sn químico al aumentar el *intermetálico* (según gráfico). El *intermetálico* es la aleación no soldable que se forma entre el cobre base y la micra de estaño. Esta aleación va "creciendo" con el tiempo y la temperatura, cuando llega a la superficie, la soldabilidad se ve afectada.

Como se puede ver en el gráfico, al año sigue teniendo 0,7 micras aproximadamente de estaño puro, permitiendo múltiples reflows. Aunque a los 12 meses la soldabilidad está sobradamente comprobada, a partir de esta fecha aconsejamos reprocesar los circuitos.